

# IR Day 2025

株式会社 村田製作所

## お伝えしたいこと

- Vision2030の世界観が現実化していく中、AIによる加速的な変化を捉え、足元だけではなく中長期的な未来への解像度を高めていくこと
- ムラタのコンデンサが持つ強さの源泉とその強さを更に高めていくことに加え、環境取り組みが『社会価値と経済価値の好循環』として顧客価値・収益性向上につながっていること
- 組織・人的資本および財務資本を強化・変革し、適切に再配分することで、拡大するエレクトロニクス市場における強固な経営基盤構築が着実に進展していること

01 – 中期方針振り返り

02 – 2030年の世界観と事業機会の獲得

03 – コンデンサ事業の強さの源泉と環境取り組み

04 – 持続的な価値創造に向けた資本戦略

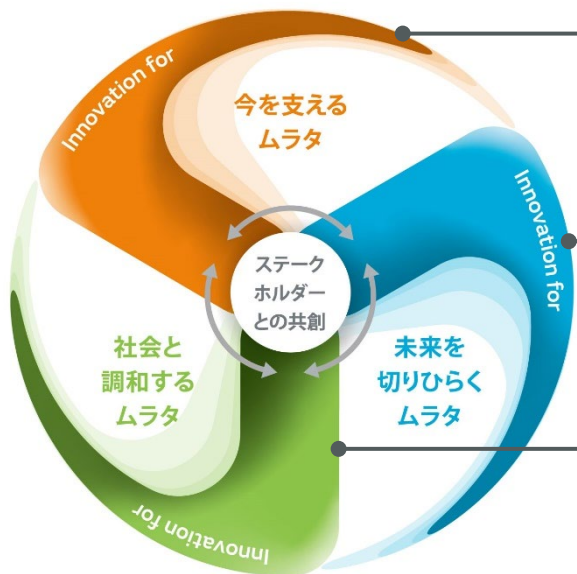
# 01

---

## 中期方針振り返り

## Innovator in Electronics

ムラタのイノベーションで社会価値と経済価値の好循環を生み出し、豊かな社会の実現に貢献していきます



### 社会基盤に深く根付く

人々の衣食住を豊かにするための社会インフラに、ムラタの電子部品は必要不可欠なものとして使われています。ムラタは今後も継続的なイノベーションで社会ニーズに応え、部品の進化を図っていきます。ムラタの部品が社会に広く、深く根付いて、暮らしの“今”を支えます。

### 社会課題解決を加速する

社会課題解決のツールとしても、エレクトロニクスは幅広く活用されています。ムラタは部品の提供にとどまることなく、エレクトロニクスを突破口として、地球、社会の持続可能性を追求していきます。ムラタのイノベーションが、より自由で、暮らしやすい未来の実現を加速させます。

### 持続可能な事業プロセスを追求する

事業オペレーションで生じる社会や環境への負荷低減においても、ムラタはイノベーションを生み出し、社会と調和する事業プロセスを約束します。

**Global No.1 部品メーカー**

～ムラタがお客様や社会にとって最善の選択となる～

## 中期方針2027

### Vision2030実現に向けた 解像度を上げる3年

#### 基本方針

1. AIがドライブするエレクトロニクスにおける飛躍的な成長
2. 持続可能な事業プロセスの追求
3. 経営資本の中核である人・組織力の強化

#### 重要環境認識

##### <マクロ環境認識>

- ・新興地域の存在感の高まり
- ・地政学リスクの複雑化
- ・サステナビリティ意識の経済活動への組み込み
- ・デジタル化による社会変容

##### <業界・自社環境認識>

- ・質的变化：AIが切りひらくエレクトロニクスの革新
- ・量的変化：エレクトロニクス領域のコモディティ化と拡大
- ・資本効率改善の重要性の高まり

## Vision2030

### 成長戦略

#### 基盤事業の深化と ビジネスモデルの進化

1

標準品型ビジネス

2

用途特化型ビジネス

3

新たなビジネスモデル創出

#### 事業機会

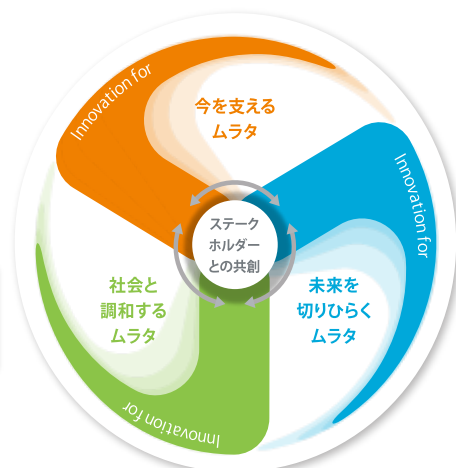


#### 4つの経営変革の実行

- 社会価値と経済価値の好循環を生み出す経営
- 自律分散型の組織運営の実践
- 仮説思考にもとづく変化対応型経営
- デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進

### Innovator in Electronics

ムラタのイノベーションで  
社会価値と経済価値の好循環を生み出し、  
豊かな社会の実現に貢献していきます



### Global No.1部品メーカー

～ムラタがお客様や社会にとって最善の選択となる～

# 中期方針2027の進捗

## 経済価値

|                         | 2024年度    | 2025年度    |        | 2027年度目標 |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|----------|
|                         | 実績        | 予想(10月発表) | 前年度比   | 目標       |
| 売上高                     | 1兆7,434億円 | 1兆7,400億円 | ▲0.2%  | 2兆円以上    |
| 営業利益率                   | 16.0%     | 16.1%     | +0.1pt | 18%以上    |
| ROIC(税引後) <sup>※1</sup> | 10.0%     | 9.7%      | ▲0.3pt | 12%以上    |

## 社会価値

### 環境

| GHG※2排出量(2019年度比) | 2024年度 | 2027年度目標 | 2030年度目標 | 長期目標                      |
|-------------------|--------|----------|----------|---------------------------|
| Scope 1+2         | 35%減   | 39%減     | 46%減     | CN <sup>※3</sup> (2040年度) |
| Scope 3           | 24%減   | データの精緻化  | 27.5%減   | CN (2050年度)               |

|                          | 2024年度 | 2027年度目標 | 2030年度目標 | 長期目標          |
|--------------------------|--------|----------|----------|---------------|
| 再生可能エネルギー導入比率            | 39.2%  | 55%      | 75%      | 100% (2035年度) |
| 持続可能な資源使用率 <sup>※4</sup> | 約15%   | 16%      | 25%      | 100% (2050年度) |
| 循環資源化率 <sup>※5</sup>     | 40.3%  | 41%      | 50%      | 100% (2050年度) |

### 多様性・ES

|                         | 2024年度     | 2027年度目標   | 2030年度目標   |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| グローバル経験者数 <sup>※6</sup> | 3年累積1,113人 | 3年累積1,500人 | 6年累積3,000人 |
| 女性管理職比率 <sup>※7</sup>   | 4%         | 7%         | 10%        |
| 従業員エンゲージメント肯定回答比率       | 67%        | 71%以上      | 76%以上      |

※1 当中期方針から、開示するROICを税引前から税引後に変更しています。ROIC(税引後) = 税引後営業利益÷期首・期末平均投下資本(有形固定資産・使用権資産・のれん・無形資産+棚卸資産+営業債権-営業債務)

※2 Greenhouse Gas 温室効果ガス ※3 カーボンニュートラル ※4 主に枯渇リスクの高い24資源におけるリサイクル材使用の重量割合 ※5 ムラタの排出物(廃棄物+有価物)が循環資源化された重量割合

※6 2025年以降に、本国以外への異動や研修・リモートアサインメントでグローバルな経験をした国内外社員の累積数 ※7 村田製作所単体

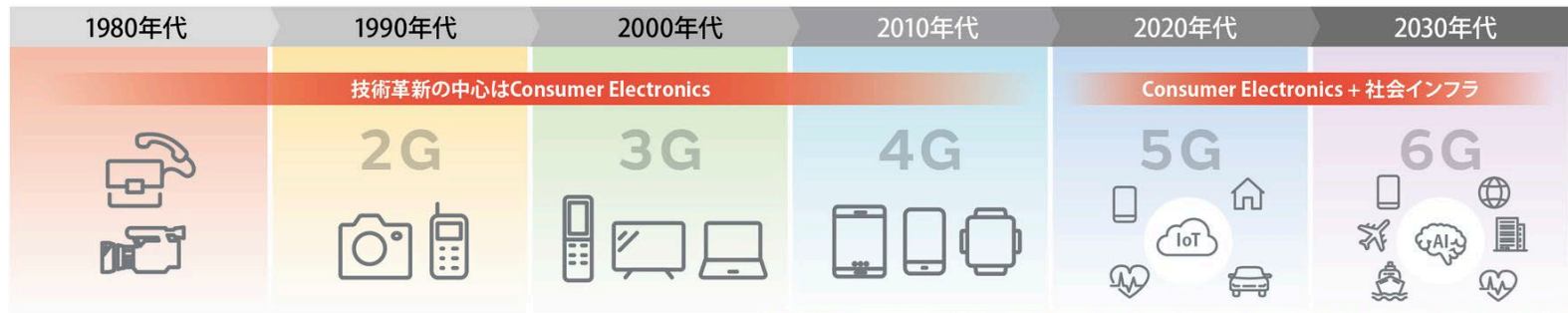
# 02

---

## 2030年の世界観と事業機会の獲得



# Innovator in Electronicsの波



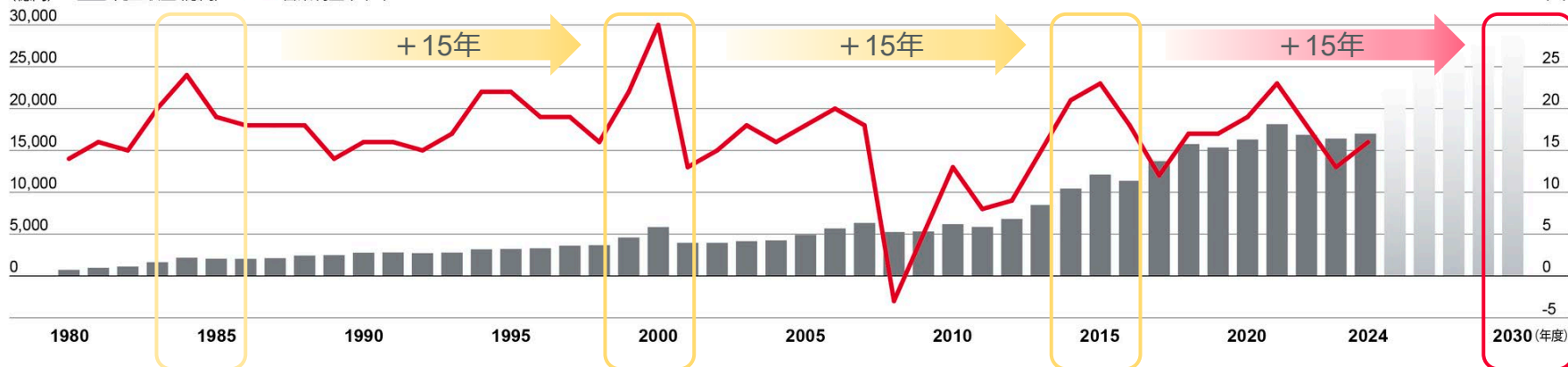
3層目 ハードだけでなく、ソフト・ソリューションも組み合わせた価値提供

2層目 お客様とのすり合わせによる具体的な用途提案

1層目 ハードウェアの進化に貢献する最先端の電子部品の提供

## ムラタの業績推移

(億円) ■ 売上収益(億円) — 営業利益率(%)

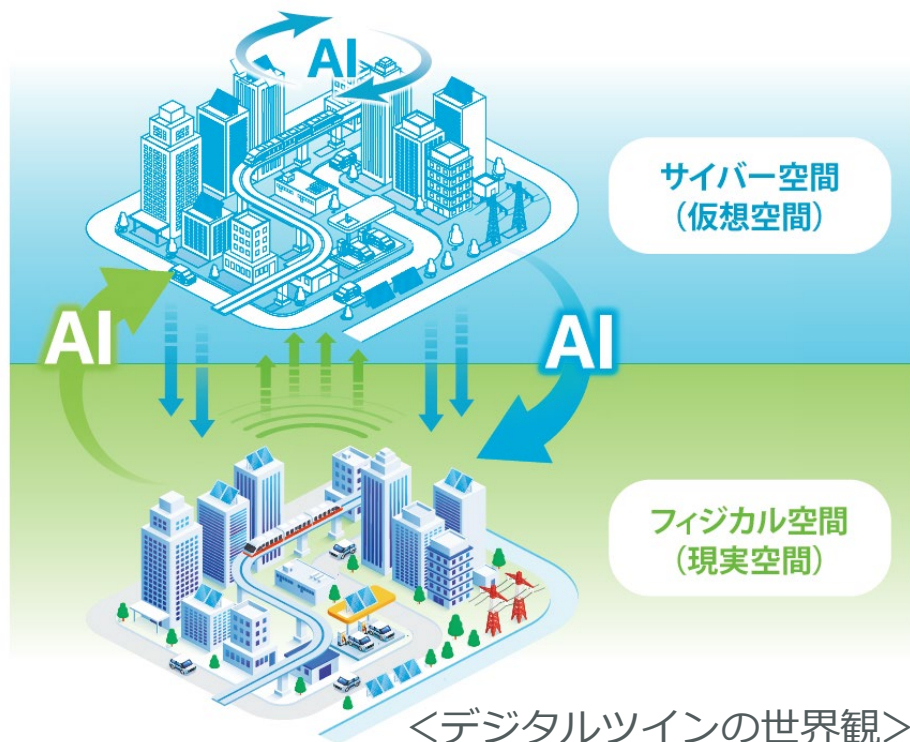


# AIが加速させる環境変化

AIにより電子部品を取り巻く環境変化が急速に進み  
需要機会が加速度的に広がる

製品の高性能化

開発・新技術の加速



新分野・用途拡大

生産力の向上

# AIの進化を見据えた基盤領域の将来需要機会

## AIの進化

LLM（大規模言語モデル）

AIエージェント

AGI（汎用人工知能）

ASI（超人工知能）

### エッジデバイス



スマートグラス



スマートリング



6G



生体エレクトロニクス

小型パッケージ・低消費電力通信・ハプティクス

高速大容量・低遅延通信

インプラントブル

### ITインフラ



AI データセンター

垂直電力供給  
半導体パッケージ



光通信

光電変換・光電融合  
半導体パッケージ



分散コンピューティング

電力制御・同期・分散処理

### モビリティ



AD/ADAS

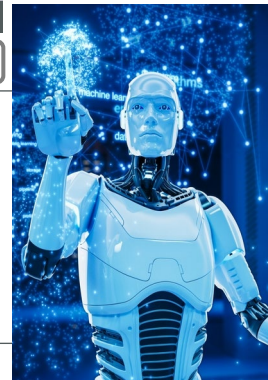
高精度センシング・高精度ナビゲーション



ドローン



産業用ロボット



ヒューマノイド

ハーネスレス無線通信  
・センサフュージョン  
・アクチュエーション



スペース

量子通信・時刻同期

ムラタが  
提供し続ける価値

小型・大容量・高効率・高密度・高信頼性・熱対策

# エッジデバイス (将来、変化の兆し)

## AI/インターフェース多様化



スマホ/タッチ入力



PC/キーボード入力



人の感覚や想いなど  
より自然で直感的な  
インターフェースへ

## 生体センシング



作業者安全モニタ  
リングシステム



ストレッチャブル基板



Moni-Patch 深部体温  
センサシステム

## mask voice clip



騒音環境でも高精度な  
音声入力が可能



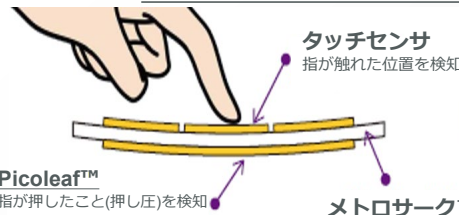
AIやデジタル技術の活用範囲  
を広げる次世代のインター  
フェイス技術に注目する

## ニオイセンサ



人が感じにくいわずかな  
ニオイを検出・識別可能

## Picoleaf™・メトロサーク™のデバイスへの活用



メトロサーク™

## 高密度実装基板イメージ



拡張機能追加回路部  
球面、曲面へのVia配置による多層  
配線で実装密度、面積UP

# エッジデバイス（高速大容量・低遅延通信・同時多接続）

高速大容量・低遅延通信・同時多接続への対応

## 需要機会



## 市場技術トレンド

- あらゆる情報を取得しデジタル化する
- 処理能力や通信能力の高速通信への対応が進む
- 低遅延での同時多接続が必要な領域、様々なインターフェイスとつながる

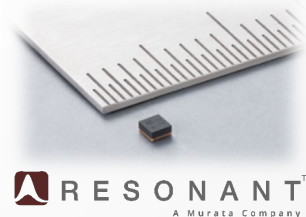
## 事業機会

- 小型高性能コンポーネントやモジュールの需要増
- 帯域幅の広い高性能な高周波フィルタのニーズの高まり
- 低消費電力、高効率化への技術的要求の高まり

## XBAR

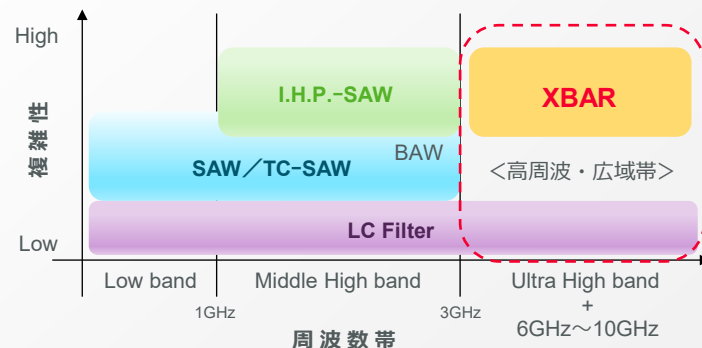
### 「25年度XBAR出荷開始」

- 3GHz以上の高周波数帯で、低損失、高減衰、広域帯を実現
- SAWフィルタの技術を活かした、高い品質と価格競争力の両立



### ＜各フィルタと対応周波数帯＞

- 3GHz以上の高周波数帯の2028年までの年平均成長率は17%
- XBARは、難易度の高い高周波数・広域帯で優位性を発揮





## AIサーバー向けコンデンサ需要の高まり

### AIサーバーにおけるトレンド

- AIサーバーの演算処理能力は継続的に高まる  
⇒AIサーバーのAIアクセラレーター数の増加
- 大量の電力を瞬間的に消費し、安定した動作を保つために必要な電力を一時的に蓄えるため、AIアクセラレーター内のコンデンサの数も増加

AIサーバー全体のコンデンサ搭載員数は増加傾向

### ■コンデンサ搭載員数見直し

<平均員数>

中期方針2027  
時点

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| AIサーバー<br>※Baseboard | 10,000 ~ 20,000 |
|----------------------|-----------------|

今回見直し

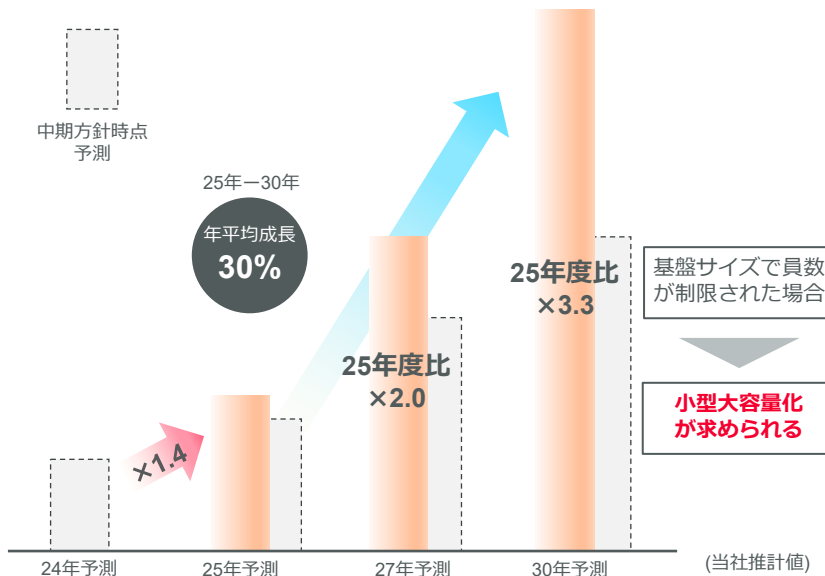
|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| AIサーバー<br>※Baseboard | 15,000 ~ 25,000 |
|----------------------|-----------------|

### 中期方針2027時点からの変化点

<変化点>

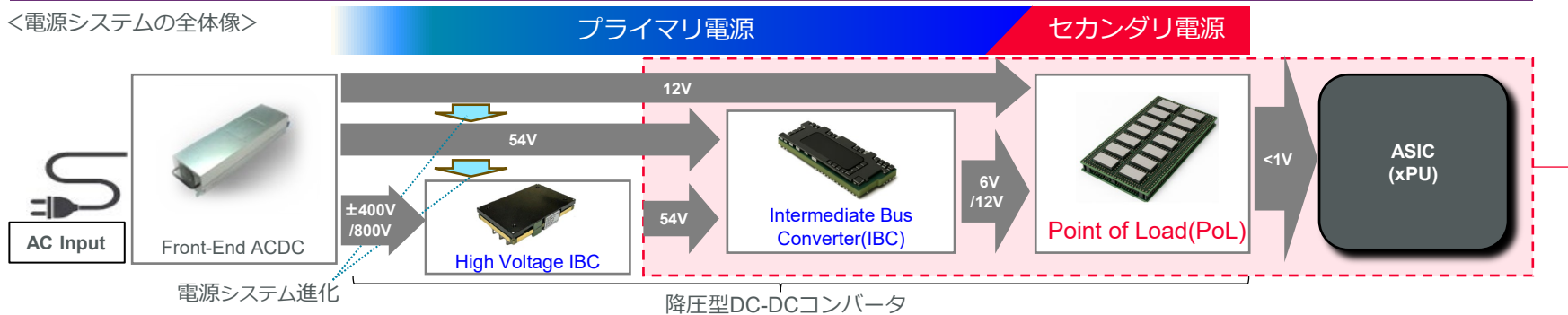
- AIサーバー総台数予測：変化無し
- コンデンサの搭載員数：増加

### ■AIサーバー向けコンデンサ需要予測(当社コンデンサ数量ベース)



## AIサーバー向け電源の需要増加

<電源システムの全体像>



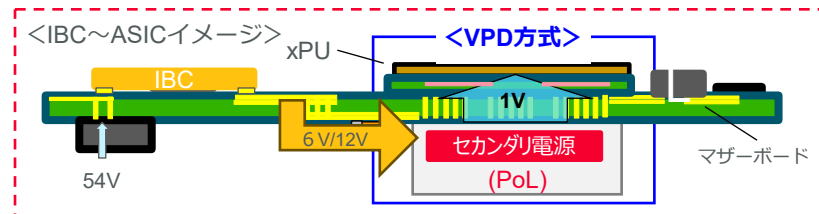
### 電源システムのトレンド

- ・サーバーの消費電力増加に伴い、電源システム全体のロス低減のため、フロントエンドDC電圧の高電圧化が進む  
(電源システムの進化：12V → 54V → ±400V/800V)
- ・電圧の降圧比が大きくなるため、複数のDC-DCコンバータが必要となり新たなDC-DC電源モジュールの需要が生まれる

### 垂直給電方式の進展

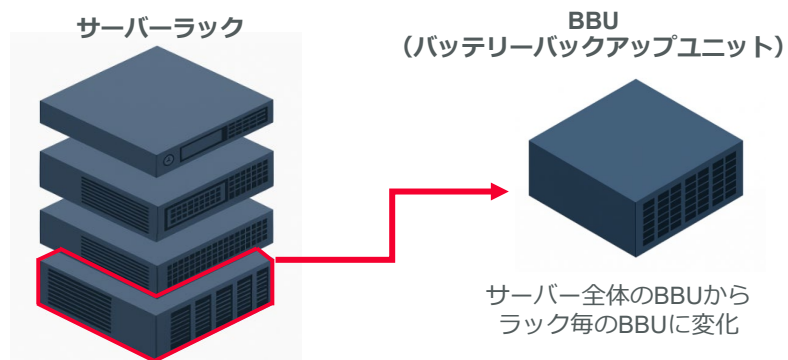
- ・次世代プロセッサ（xPU）への電源供給は垂直給電（Vertical Power Delivery: VPD）方式の採用が進む
- ・VPD方式は、次世代プロセッサ（xPU）への電源供給距離を大幅に短縮し、電圧降下や配線長による損失を抑制することで、より高効率かつ安定した性能の実現が可能

ムラタは多様な電源の提供によりAIサーバーの成長をサポート  
26年度の「セカンダリ電源」売上獲得に向けて取り組み中



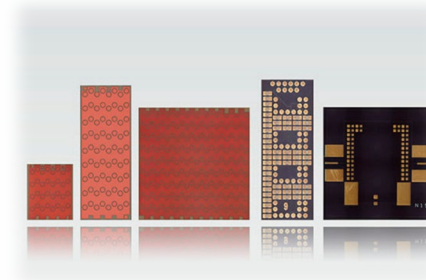
## AIサーバー向けその他のトレンド

### バッテリー（電池）のトレンド



### 新たなビジネスの実現に向けて

#### コンデンサインダクタ内蔵基板（iPaS™）-アイパス-



#### ■ 市場のニーズ

| 項目  | 市場ニーズ                                 |
|-----|---------------------------------------|
| 高出力 | 消費電力が莫大なため単位体積あたり高い出力の電池が必要           |
| 高安全 | データセンターの火災が相次ぎ、安全性の高いLFP（リン酸鉄リチウム）の要求 |
| 長寿命 | 5-10年保存後も安定して出力、Runtimeが出せる           |

#### ■ 必要な製品

| 集電タブ | 材料  | 容量 | 市場ニーズ |     |     |
|------|-----|----|-------|-----|-----|
|      |     |    | 高出力   | 高安全 | 長寿命 |
| あり   | 3元系 | 大  | ×     | ×   | ×   |
|      | LFP | 小  | ×     | ○   | ○   |
| なし   | 3元系 | 大  | ○     | ×   | ×   |
|      | LFP | 小  | ○     | ○   | ○   |

- 搭載面積として広いスペースを要する表面実装デバイスを内蔵することでお客様の省スペース化、省電化、高機能化に貢献
- iPaS™は数10A以上の大電流に対応可能な仕様で、電源供給ラインや高性能半導体のパッケージ向けに「垂直電源供給」の設計が可能



## SDV(Software Defined Vehicle)/OTA(Over the Air Update)

### <SDV・OTA>

- ・自動車の機能や性能をソフトウェアによって制御・更新できる車が増加。無線通信を使ってソフトウェアを更新
- ・車体に搭載されるECUは長期間使用することを前提に将来の機能の追加・更新、情報セキュリティを見越して製造段階で高品質・高性能な部品の需要が高まる

ADASレベル2+の搭載車数は2027年度にかけて加速し、約2.8倍の増加を見込む。



### モビリティ向け製品情報



世界最高水準の高精度な自動車向け6軸慣性センサを開発



世界初、C-V2X通信（5.9GHz帯）向け自動車用ノイズ対策フェライトビーズを商品化



世界初、-40～125℃の広い使用温度範囲で周波数偏差±40ppmの高精度を実現した自動車向け水晶振動子を開発

# 中期課題の進捗状況

## 中期課題 1

▶ 高周波領域における  
差異化技術の追求とシェア拡大

- ・ 高周波モジュールへの取り組み
- ・ XBARの量産出荷開始(25Q1)

## 中期課題 2

▶ 電池事業の安定的な収益貢献と  
ESS市場での価値提供

- ・ 電池黒字化達成(通期黒字化見込み)
- ・ パワーツール、サーバー、ESS市場での更なる事業拡大

## 中期課題 3

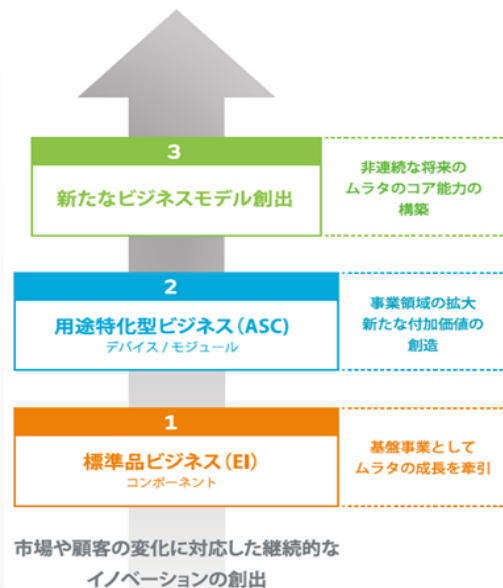
▶ AIサーバー向け電源の需要獲得

- ・ セカンダリー電源への取り組み

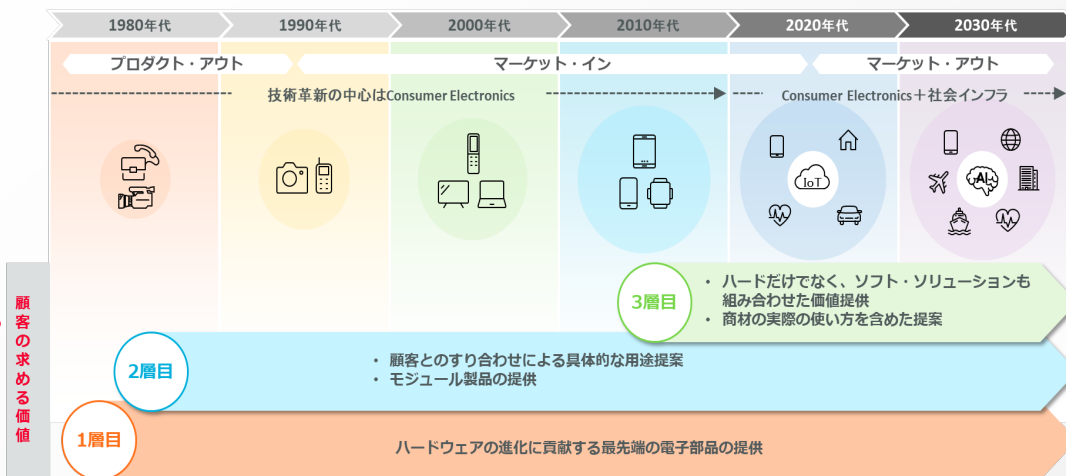
# 3層ポートフォリオ経営に込めた思い

## ビジネスモデルの全体像

### Innovator in Electronics



## 3層ポートフォリオ経営に取り組む理由



顧客ニーズの変化や技術革新に合わせてビジネスモデルも変革

# 共創で作るエレクトロニクスの未来

## 日米間の投資に関する共同ファクトシートに参画



- ・先進電子部品の供給および米国におけるサプライチェーンの強化【最大150億ドル】
- ・自社の電子部品供給により貢献
- ・科学技術分野の発展に協力することで、長期的な成長につなげる

## KyoHA(京都ヒューマノイドアソシエーション)への参画



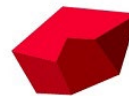
- ・モノづくりの都・京都にて、日本の技術力を結集する新たな産業連携の枠組みとして「KyoHA」を設立
- ・実用性の高いヒューマノイド実現に向けて、ハードウェア領域における統合的な取り組みに貢献

## 新たなセラミックの可能性への挑戦



- ・QuantumScape社固体電池へのセラミックセパレーターの共同開発契約を締結
- ・セラミックス材料の調合、シート成形、焼成に関する技術を応用することで固体電池の量産化に貢献

## CVC※を通じた革新的なスタートアップ企業との協創



**WONDERSTONE**  
Ventures

### 【投資領域】

- ・次世代通信／6G、環境生体エレクトロニクス、ロボティクス、スペース、光・半導体、

### 【投資ポートフォリオ】



# 環境への取り組み

気候変動対策：GHG・エネルギーを削減

## クリーンエネルギーをつかう社会



muRata ショーケース～社会実装



地域社会



仕入先様

社会への貢献と事業機会の創出

資源循環：廃棄物・環境負荷を削減

## 資源を循環利用する社会



製造業としての活動の中で環境課題に対して  
真剣に解決策を練って、自社実装し、効果を  
確認した策は顧客の価値にもなる

環境に対する取り組みは今後も継続していく

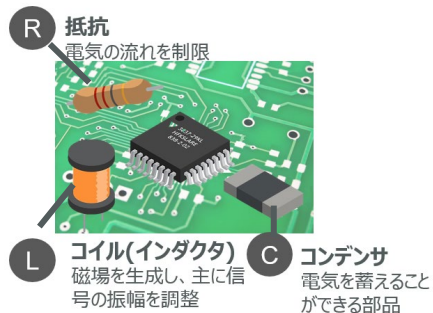
# 03

---

## コンデンサ事業の強さの源泉と環境取り組み

# コンデンサの役割

## 電子部品の機能



## コンデンサの役割

- ・電子機器に使われている汎用部品の一つで電気回路の安定動作をサポートするもの
- ・電気エネルギーを一時的に蓄え、放出したり、周波数特性を利用して必要な成分のみ通したり、遮ったりする電子部品
- ・あらゆるエレクトロニクス製品に使用
- ・用途ごとに応じたアイテム選定が可能

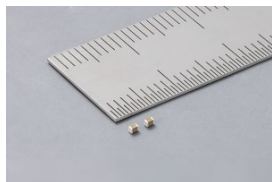
## あらゆるエレクトロニクス製品に搭載

- ・スマートフォン
- ・ウェアラブル
- ・モビリティ
- ・ITインフラ
- ・AIデータセンター
- より繊細な機器に搭載
- 搭載される員数も増加傾向

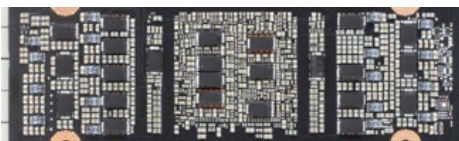
## 今後さらに高まるコンデンサのニーズ

AIデータセンター用回路基板では効率的な部品配置が求められる

→小型大容量化に加え、発熱に伴う高温環境下でも使用可能な高信頼性のニーズが高まる



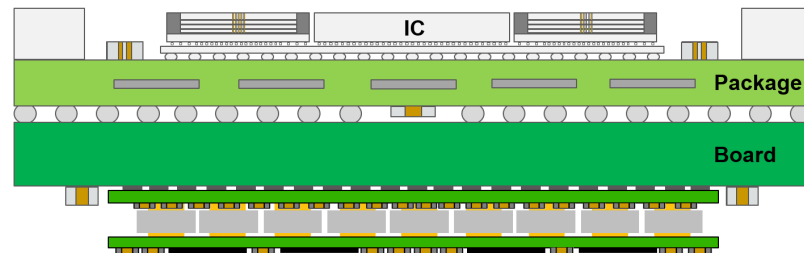
1005Mサイズで静電容量47 $\mu$ FのMLCCを世界で初めて量産



AIデータセンター用回路基板の裏側（一部）

## 基板埋め込み型コンデンサ

高性能半導体の電力損失を抑えるために最短距離での配線を実現する設計が求められる



基板埋め込み型コンデンサの断面図

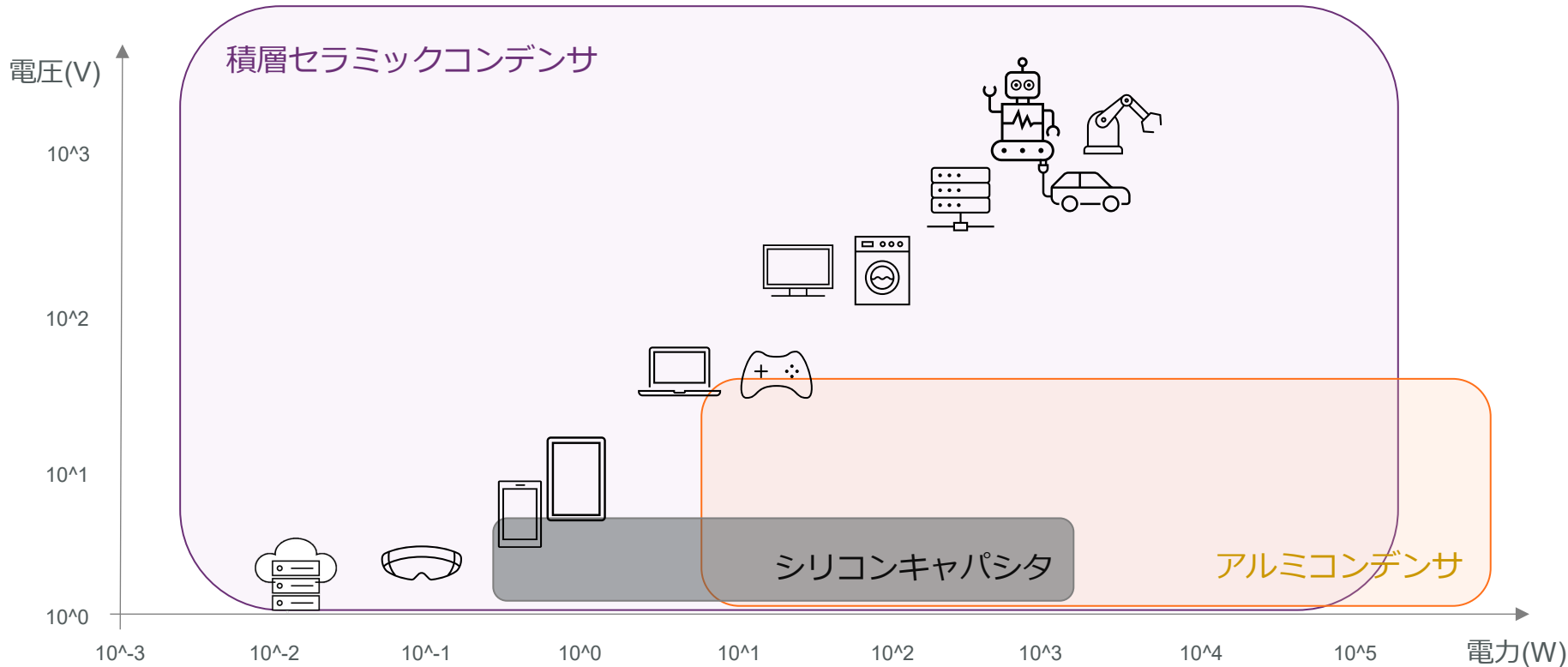
コンデンサのトップメーカーとしてお客様の幅広いニーズに応えるため、全方位でラインナップの拡充を図る





# 市場の広がり

これまでも豊富なラインナップにより市場の変化を捉えエレクトロニクスの発展に貢献してきた  
今後も全方位戦略を維持しつつ、将来も成長が見込まれる製品・事業機会を確実に捉える



# 垂直統合型ビジネスの強さ

## 垂直統合型ビジネスの強さ

- ・コア技術のブラックボックス化による競争力
- ・材料から製品／設備まで高度なすり合わせ
- ・高品質で安定的な供給
- ・源流管理、未然防止、継続的改善のPDCAサイクル

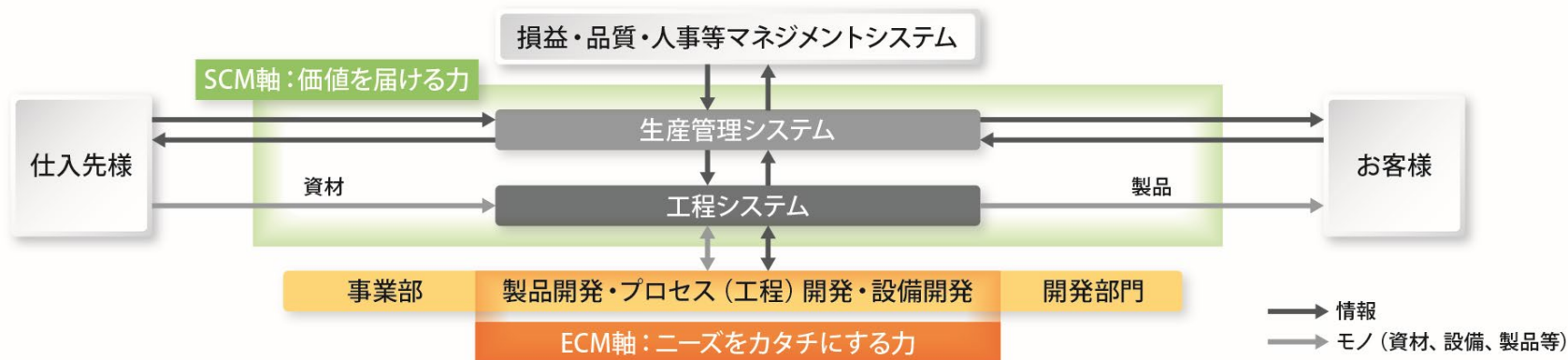


## 今後さらに高めていく強さ

- ・大量で多様なデータを繋ぎ均一な製品を供給する仕組み
- ・材料と設備の開発連動による一貫した技術力
- ・質の高いデータを生かした意思決定の迅速化
- ・業界先駆の経済価値と社会価値の好循環させた取り組み

## ムラタのモノづくりの領域

- ・固有技術と管理技術を駆使してSCMとECM軸双方ですり合わせし、技術の差異化と高い付加価値を実現
- ・特に、重要な生産設備は自社で設計・内製化し、新しい商品や生産プロセス導入時に品質とコストの作りこみを実現



# 価値を届ける

広がるマーケットの供給ニーズを満たすことがグローバルシェアNo1であるムラタの使命の一つ

## “Made by Murata”

- ・有事の際の安定供給と供給工場変更の柔軟性を確保
- ・供給工場変更の柔軟性によるマルチ化

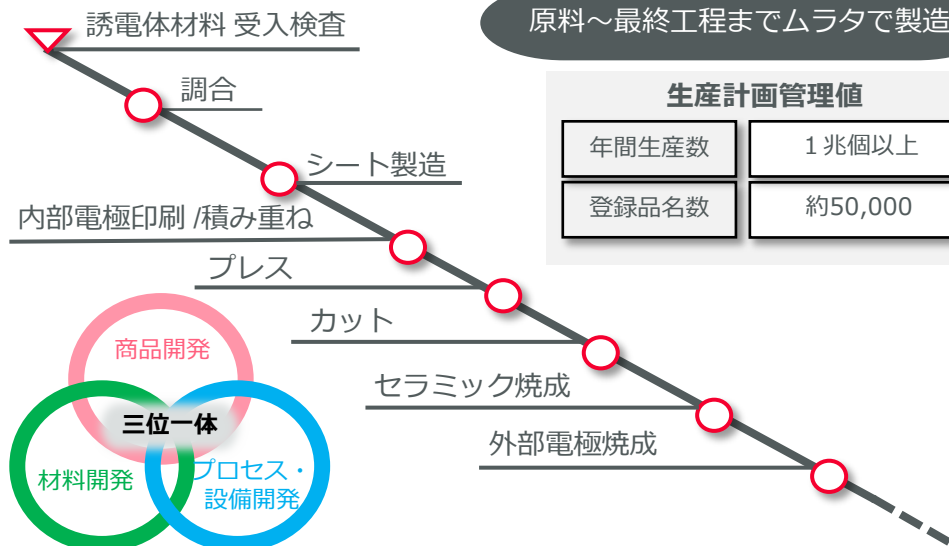
## すり合わせによるモノづくり

- ・原料から最終工程まで多くのプロセス・登録品名などを扱い、膨大な情報を相互ですり合わせしコントロール
- ・工程毎に変わる設備や員数の違いをハイサイクルに管理・調整

## セラミックコンデンサの生産拠点



## 生産工程（例）



### 生産計画管理値

|       |         |
|-------|---------|
| 年間生産数 | 1兆個以上   |
| 登録品名数 | 約50,000 |

# ニーズを形にする① ～商品開発～

サーバーを含む市場では静電容量の増加が求められており、その実現には実効容量を高めたMLCCが必要

## 課題

### DCバイアス特性

- MLCCにDC電圧をかけた時に実効的な静電容量が変化（減少）してしまう現象。電圧の大きさに関わらず変化

### スイッチング周波数

- 電子回路で電流を高速に切り替える動作（高周波動作）でも容量を安定維持する特性

### スペース制約

- 基板の小型化や搭載部品の増加に伴い、スペース制約が発生し小型大容量のMLCCが求められる

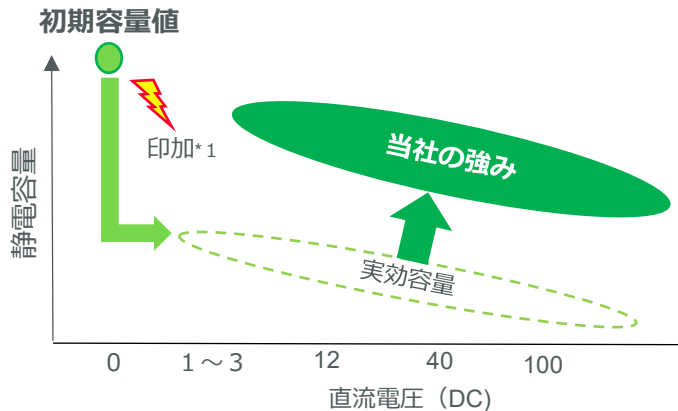
実効容量を高める

## DCバイアス特性

- 初期容量値が電圧印加によって大きく低下すると、回路動作が不安定になる恐れがある。

### 当社のMLCCの

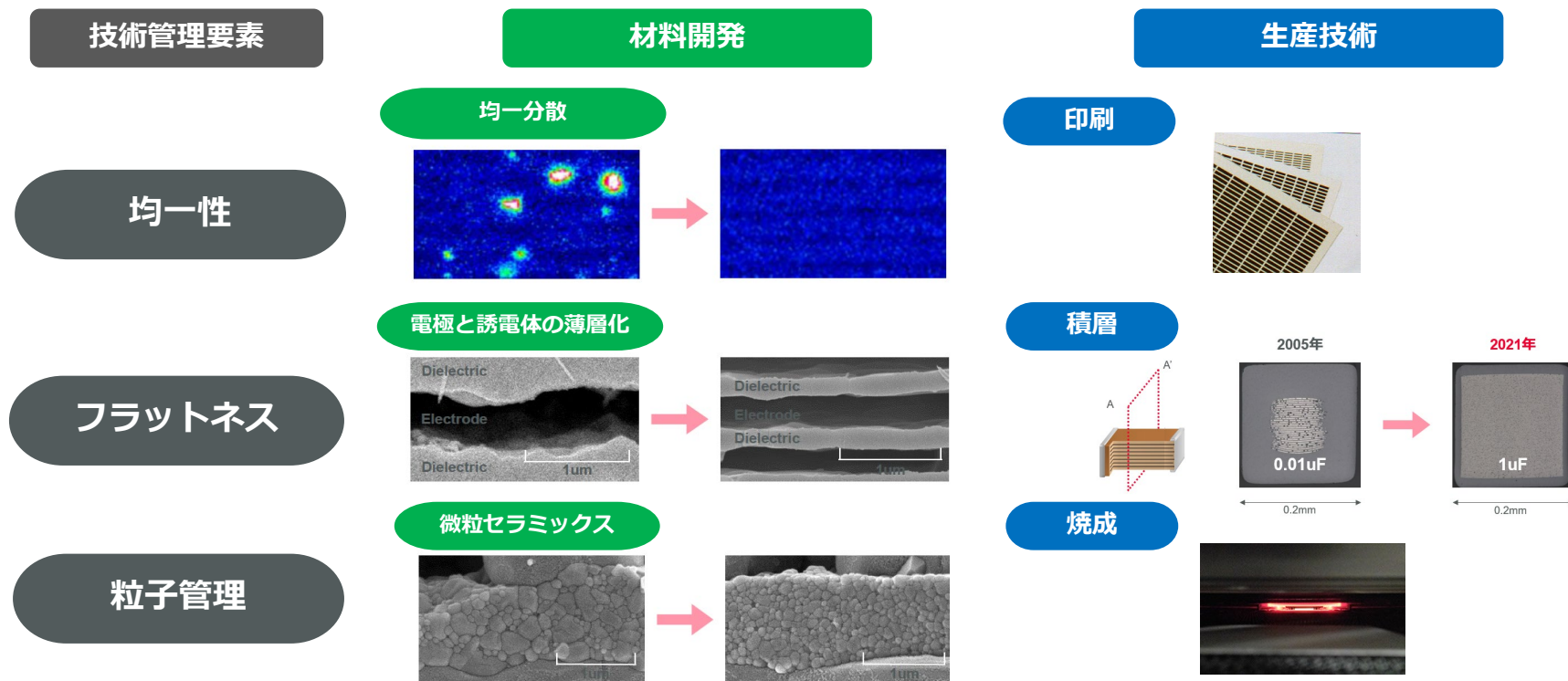
**強みは電圧をかけた時の実効容量が高いこと**



\*1：印加とは、MLCCに電圧を加えること

## ニーズを形にする② ～材料開発・生産技術～

材料技術と内製設備を生かした生産技術の掛け合わせにより、コア技術をブラックボックス化しつつ市場のニーズに合わせた、信頼性が高く競争力のある製品を提供



# DXによるサプライチェーンのシンカ

## ムラタならではの強み

- ・一貫生産による情報のブラックボックス化
- ・多様なプロセス・製品による膨大なデータと経験値
- ・設備内製によるデータの取りやすさ

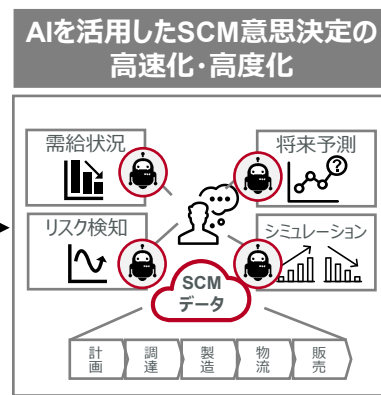
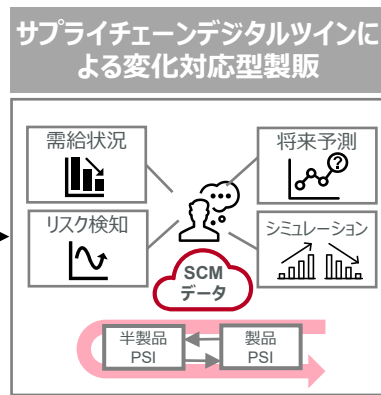
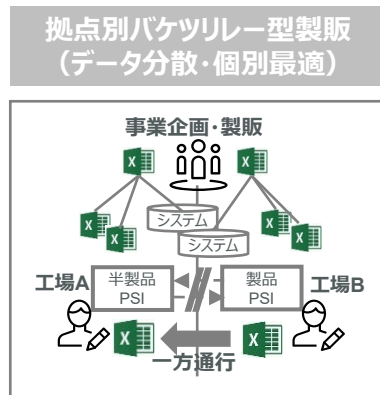
## DXによるシンカのポイント

- ・質の高い独自データを絶えず供給する仕組み
- ・リスクの検知と変化対応シミュレーション
- ・属人、都度対応からの脱却
- ・製造ラインでの習熟期間短縮による急激な変化への対応

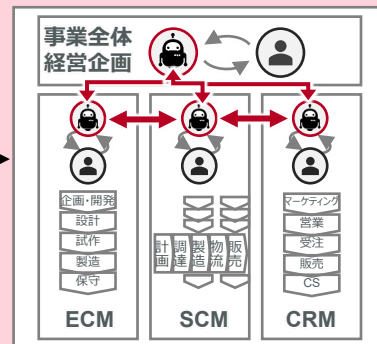
## ムラタの目指すサプライチェーンの改革ロードマップ

- ・膨大なデータと経験値によって運用されていた情報を、DXにより更に質の高い事業運営ができるよう目指している
- ・これまでのSCM工程システムだけでなく、変化する市場を正確に捉えスピーディーかつタイムリーに価値を届ける

### 目指す姿



### SCM以外のデジタルツインとの 連携による事業運営



# 脱炭素社会の実現①

顧客のニーズに先駆け、カーボン排出量削減等で**顧客のScope 3の削減取り組みに貢献します**

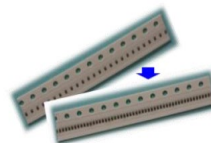
## 通常テーピング

### <テーピングの機能>

1. 電子部品の実装を効率化
2. 搭載中の破損のリスク低減

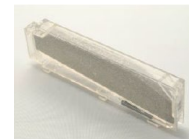
## ピッチを詰めてテーピング材を減らす

**狭ピッチ**  
W8P2→W8P1  
(1005M)



## テーピングを使わない実装技術の確立

バルク



## 貢献する社会価値


- 小型大容量により使用材料や包装材の削減
- 軽量・物量減による製造、輸送のエネルギーの削減

## 貢献する経済価値

- 環境対応による製品の競争優位性強化
- エネルギーコストの削減
- 生産効率の向上と製品ミックスの良化

## カーボン排出量の削減効果例

|               | 通常ピッチ   |
|---------------|---|
| サイズ           | W8P2  |
| 個/リール         | 10,000  |
| リール/箱         | 10  |
| 100万個出荷に必要な物量 | 外装箱 約1,000箱<br>↓<br>7パレット+約100箱<br> |

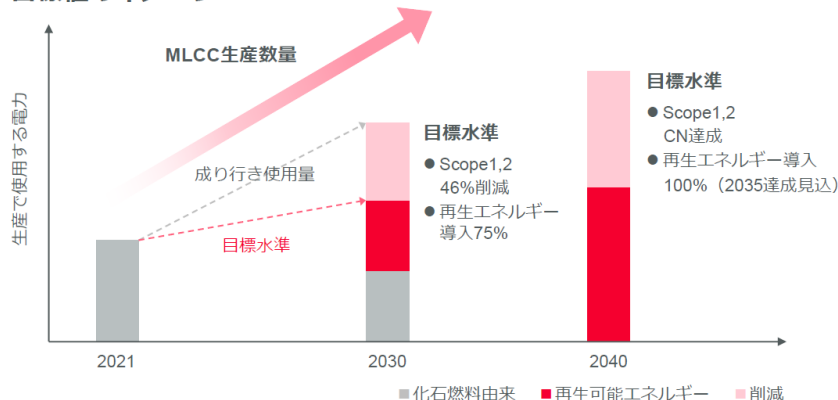
|               | 狭ピッチ   |
|---------------|--|
| サイズ           | W8P1   |
| 個/リール         | 20,000   |
| リール/箱         | 10   |
| 100万個出荷に必要な物量 | 外装箱 約500箱<br>↓<br>3パレット+約120箱<br> |

**4パレット削減**

## GHG排出量削減目標

- 生産量の増加に伴い電力の絶対量は増加するが、再生可能エネルギーの活用とエネルギー費削減によりカーボンニュートラルの達成を目指す

### 目標値のイメージ



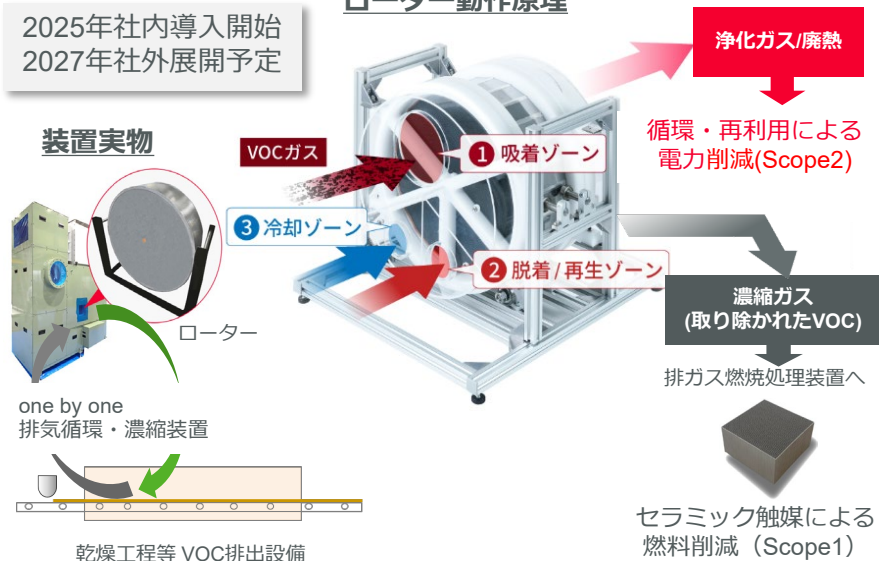
## 工場排ガス処理における削減取り組み

- セラミックコンデンサの技術を応用し、小型かつ軽量の排気循環濃縮装置を開発
- 燃料から発生するCO2削減としてScope1、浄化ガス/廃熱の再利用による加熱の電力削減としてScope2の削減に貢献

### ローター動作原理

2025年社内導入開始  
2027年社外展開予定

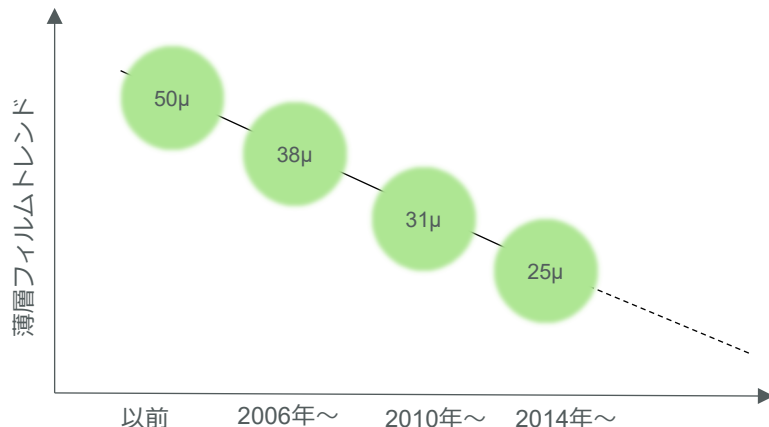
### 装置実物





## 間接材の省資源化（PETフィルム）

- MLCC製造プロセスで使用するPETフィルムは薄層大容量化に伴い使用量が増加する
- PETフィルムの使用量を抑制するために薄いPETフィルムで生産できる技術確立を進めてきている
- この取り組みでは経済価値・社会価値双方の効果が期待される



## PETフィルムのリサイクル

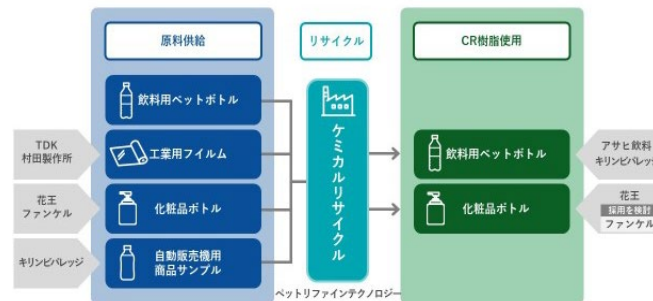
- 2025年4月、業界を超えた9社が連携し、MLCC商品の製造に使用する工業用PETフィルムをリサイクルする取り組みを開始。
- ケミカルリサイクルにより、非食品用途PET ※1を原料として、飲料用ペットボトルや化粧品ボトルなどの新たなPET資源へリサイクル※2する
- 非食品用途のPET樹脂を飲料ペットボトルの原料として再生するのは国内初※3の取り組み
- 将来的にはペットボトル換算で年間6,000万本のリサイクルを目指す

※1 ポリエチレンテレフタレート の略

※2 分子レベルまで分解し、色素や金属などの不純物を取り除くことで、石油由来と同等品質の再生PET樹脂へ再生するリサイクル手法

※3 JEPLAN調べ

### 本取り組みにおける各社の役割



# 04

---

## 持続的な価値創造に向けた資本戦略

# Vision2030実現に向けた個・組織のグローバルビジョン

Vision2030

Global No.1 部品メーカー

自律分散型の組織運営を実践し創出する **“Innovation”**

個・組織  
グローバル  
ビジョン



(個の役割)

Always be an Innovator

もっと自律的に、  
もっと個の力を発揮し、  
**おもしろい挑戦**をしていく

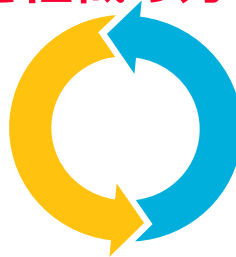
『個と組織の好循環』



(組織の役割)

Ignite People's Innovative Spirits

もっと多様な個性を受け入れ、  
もっと個の力を原動力に、  
**おもしろいを価値につなげる**



重点テーマ

①ダイナミックな適所適材

②未来変革リーダーの育成

③個と組織の好循環モデルの実現

# イノベーション創出に向けたムラタの人材戦略

## Global No.1 部品メーカー

これまでに培ってきた強み

“Innovation”

新たに培っていきたい要素



共通の  
価値観



組織間連携



積み上げ思考  
課題解決型



異なる  
価値観



多様・有機的  
なつながり



仮説思考  
未来志向



目標に向かい一体感を発揮する組織



多様な個の力が発揮される組織

①ダイナミックな適所適材

②未来変革リーダーの育成

KPI

- ・グローバル経験者数※<sup>1</sup> : 1500名（3年間実績）
- ・女性管理職比率※<sup>2</sup> : 7%

考え方

グローバルな業務経験を通じた個人の能力向上や  
地域を超えた交流による組織の連携強化を図る

KPI

- ・経営幹部候補準備率※<sup>3</sup> : 300%以上

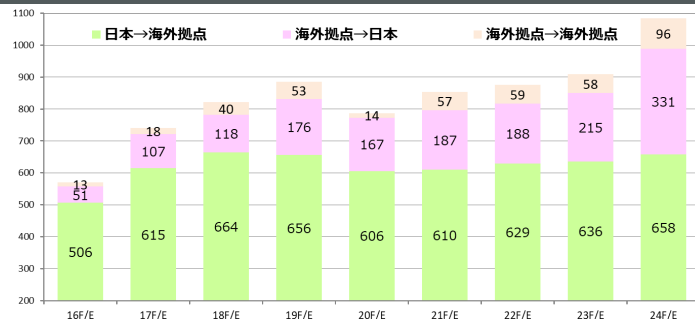
考え方

持続的な組織運営のため、次世代経営リーダーの  
継続的な育成を重要経営課題とし、成長支援を強化

# 重点テーマにおける取り組み①

## ①ダイナミックな適所適材

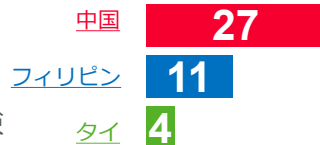
海外赴任の状況（海外語学研修参加者・海外拠点実務研修生35名を含む）



### ■海外工場実習

☑ 多様な視点を育み、部門や拠点を越えた連携を促進していきたいと考え、**グローバルに他拠点での業務経験ができる機会を提供**

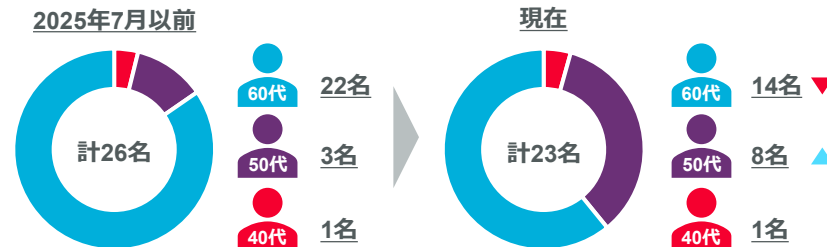
新入社員407名のうち、  
**42名**が海外工場実習を経験



海外勤務への意欲・適応力向上

## ②未来変革リーダーの育成

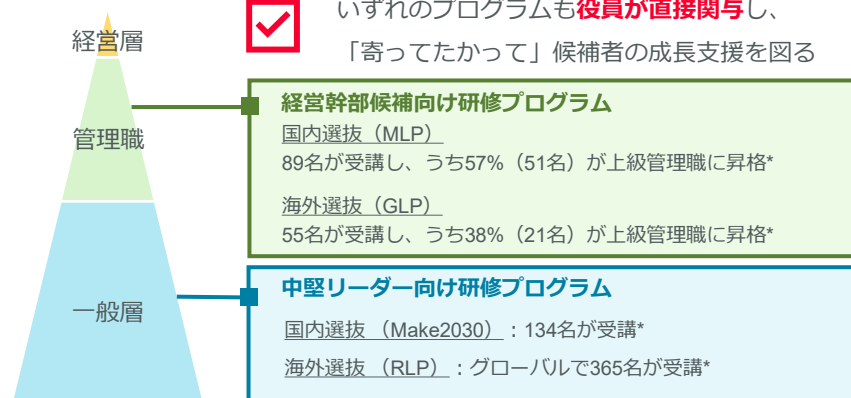
年代別執行役員構成比率



### ■選抜教育プログラム

\*受講者数や昇格者数は開始年度から2024年度末までの累計

☑ いずれのプログラムも**役員が直接関与**し、「寄ってたかって」候補者の成長支援を図る



# 重点テーマにおける取り組み②

## ③個と組織の好循環モデルの実現

KPI

サーベイ設問「組織の壁を越えたアイデアや  
リソースの共有が行われている」の肯定回答率: 70%以上

考え方

多様な個の力をより生かし、侃々諤々の議論を行うことで、  
組織の力をより強化していく。

### ■従業員エンゲージメント調査



年に一度、**国内外全拠点の全従業員を対象**に実施  
2024年度回答率: **95%**

### ■役員主催研修



**執行役員23名全員**が国内外の拠点を訪問  
戦略・方向性や協力体制などへの理解を深める

#### 従業員エンゲージメントのさらなる強化のために必要なカテゴリ

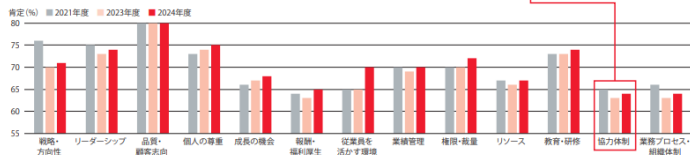
##### 戦略・方向性

##### 協力体制

#### ■従業員エンゲージメント 2024年度調査結果の概要



#### ■調査結果のカテゴリ別推移(グローバル)



#### 2024年度開催拠点

国内: 26拠点 海外: 13拠点



## 業績連動型株式報酬制度（PSU）

対象：執行役員

2025年6月に、連続する3事業年度を通じた  
中期の企業価値向上に対するインセンティブと  
することを目的とした株式報酬制度を策定

経営目標等に対するコミットメントの強化

## 持株会RS

対象：従業員

2024年の9月に国内の従業員を対象に  
3年間の譲渡制限付きで、  
一人当たり約10万円相当の株式付与を実施

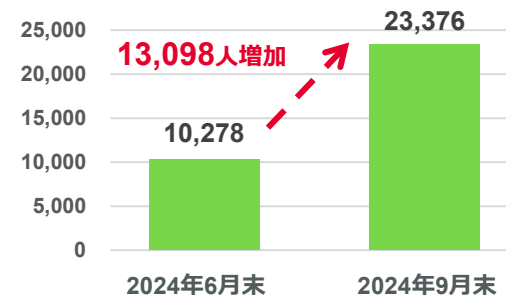
従業員の経営参画意識の向上

### ■ PSUの業績評価指標と選定理由

| 業績評価指数     | 選定理由               |
|------------|--------------------|
| 平均ROIC     | 資本効率に重きを置いた経済価値の創造 |
| 相対TSR      | 企業価値の持続的向上         |
| サステナビリティ指数 | 社会価値の創造            |

企業価値  
向上

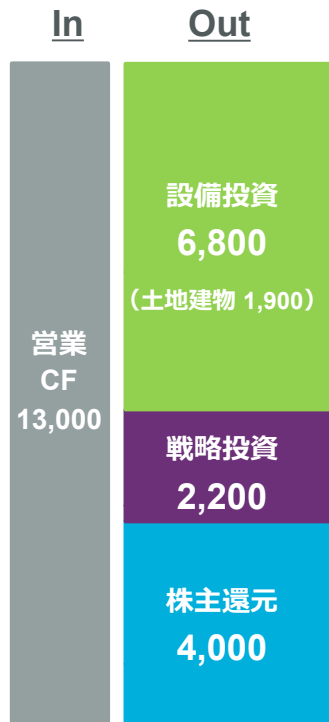
### ■ 持株会加入者数の推移



# キャピタル・アロケーション

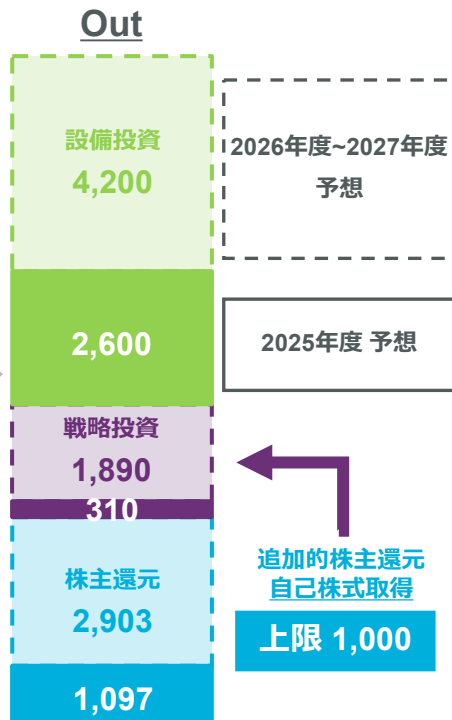
(単位：億円)

## 中期方針2027 計画



(単位：億円)

## 2025年度 予想



### ■ 2025年度 予想

- 2024年度比で+900億円増加。増加は製造外ライン投資が中心
- 新生産棟や研究開発センターなど土地建物関連で大型の案件を予定

### ■ 今後

- 主にコンポーネント等の中期的な需要増に備えた生産能力増強を行う計画
- 2026年度/2027年度は例年並みの設備投資額となる見込み

### ■ 2025年度 予想

- 2024年度比で▲10億円減少。主に環境・ITインフラ投資を計画
- M&A等成長投資は、予想値には含めていない

### ■ 今後

- 長期視点での非連続な成長を実現するために、技術獲得だけではなく、それぞれ層における成長戦略に応じて、更なる成長の選択肢として活用

### ■ 2025年度 予想

- 株主還元枠とは別枠で1,000億円を上限とする自己株式の取得を実行
- 中計期間中は取得した株式を戦略投資等での活用のために原資として保有

### ■ 今後

- 中期的にDOEを5%に引き上げ、安定的な配当を実現することを目指す
- 自己株式の取得は将来の資金需要や現在の株価水準を考慮し機動的に実施





サーバーやモビリティ向けの工程負荷の高いコンデンサを中心に**年間+10%**の能力負荷ベースでの設備投資を継続し、中長期的な需要に必要な生産能力の増強を実施

能力増強の継続のため

**土地や建物など、準備に時間を要する案件については、現在着実に進めている**

## 出雲、フィリピンでの新生産棟の建設

### 出雲村田製作所



- ・総投資額：約470億円  
（建物、生産設備含む）
- ・竣工予定：2026年3月

### Philippine Manufacturing Co. of Murata



- ・総投資額：約112億円  
（建屋のみ）
- ・竣工：2025年10月

# 将来への備え（研究開発）

AIがドライブする将来の需要機会に備え、技術力の強化を推進していくことで  
革新的な製品・技術を社会に提供し、エレクトロニクス市場のさらなる発展に貢献する

|      | 守山イノベーションセンターの設立  | 積層セラミックコンデンサ研究開発センターの設立   |
|------|---|---|
|      |  |  |
| 総投資額 | 約460億円（土地・建物費用のみ）   | 約350億円（土地・建物費用のみ）   |
| 竣工予定 | 2026年12月  | 2026年1月   |
| 目的   | 研究開発機能の拡充と外部連携の強化による<br>イノベーションの推進  | 村田製作所の主力事業であるセラミックコンデンサの<br>開発・製造における技術力の向上   |

***muRata***

INNOVATOR IN ELECTRONICS